

平成29年度 重きを置くべき施策 「ナノテクノロジー・材料基盤技術領域」

領域	分類	施策番号	期間	施策名
Society 5.0の実現に重要な技術領域	電子デバイス	エ・経18 (継続) _{H28AP}	H25～H29	次世代スマートデバイス開発プロジェクト
		エ・経17 (継続) _{H28AP}	H24～H33	超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
		エ・総01 (継続) _{H28AP}	H18～H32	「フォトニックネットワーク技術に関する研究開発」及び「巨大データ流通を支える次世代光ネットワーク技術の研究開発」
		エ・総02 (継続) _{H28AP}	H23～H32	「超高周波ICTの研究開発」及び「テラヘルツ波デバイス基盤技術の研究開発」
		エ・文04 (新規)	H29～	スキルミオンを用いた超低消費電力デバイス技術の開発
		①・経01 (継続) _{H28AP} 再掲	H28～H32	IoT推進のための横断技術開発プロジェクト
	ロボット&アクチュエーター	も・経04 (継続) _{H28AP} 再掲	H27～H31	ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト
		①・経02 (継続) _{H28AP} 再掲	H27～H31	次世代人工知能・ロボット中核技術開発
		地・経02 (継続) _{H28AP} 再掲	H25～H29	ロボット介護機器開発・導入促進事業
	基礎・共通基盤技術	①・文05 (新規)	H20～H34	光・量子技術に係る研究基盤の強化
		フ・農06 (新規) _{H28AP} 再掲	H29～H33	蚕業革命による新産業創出プロジェクト
		①・文02 (新規)	H24～H33	ナノテクノロジー・材料に関する最先端研究機器の共用プラットフォームの形成
経済・社会の多様なニーズ・課題への対応	構造材料	エ・内科03 (継続)	H26～H30	SIP「革新的構造材料」
		エ・経01 (継続) _{H28AP}	H25～H34	輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業
		エ・環03 (継続) _{H28AP}	H27～H32	セルロースナノファイバー(CNF)等の次世代素材活用推進事業
		エ・文14 (継続) _{H28AP}	H24～H33	効率的エネルギー利用に向けた革新的構造材料の開発
		エ・文12 (継続) _{H28AP}	H16～H31	低燃費・低環境負荷に係る高効率航空機の技術開発
	パワエレ	エ・内科02 (継続)	H26～H30	SIP「次世代パワーエレクトロニクス」
		エ・経04 (継続) _{H28AP}	H25～H31	電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業
		エ・文05 (新規)	H28～H32	省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体の研究開発の推進
	機能性材料	エ・経01 (継続) _{H28AP}	H25～H34	輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業
		エ・文15 (継続) _{H28AP}	H24～H33	希少元素によらない新規高性能永久磁石材料の研究開発
	触媒技術	エ・経09 (継続) _{H28AP}	H24～H33	革新的触媒による化学品製造プロセス技術開発
	統合型材料開発システム	材・内科01 (継続)	H26～H30	SIP「革新的構造材料」：マテリアルズインテグレーション
		材・文01 (継続) _{H28AP}	H27～H31	情報統合型物質・材料開発の推進
		材・経01 (継続) _{H28AP}	H28～H33	計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業
		材・経02 (新規)	H29～H33	機能性材料の社会実装を支える高速・高効率な安全性評価手法の開発
		①・文04 (継続) _{H28AP} 再掲	H24～H37	AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト